

# スマートプロセス学会誌

目次 Vol. 10 No. 6 2021 (令和3年11月)

異種・異材×接着・接合技術が拓く未来

会告	.....	N23
巻頭言	異種・異材×接着・接合技術が拓く未来 森 三樹.....	327
解説	異種材料接合と接着技術 佐藤千明.....	328
	バイオミメティック可逆的インターコネクトデザイン 細田奈麻絵.....	333
	金属 / 樹脂異種材料接合技術及び国際標準化 板橋雅巳.....	338
	半導体の多機能化に貢献する粘着・接着フィルム材料 市川 功.....	344
研究論文	成形接合のメカニズム解明のための陽極酸化ポーラスの相似性を維持した サイズコントロール 木村文信・常 昊・陳 偉彦・梶原優介.....	351
	電子実装用エポキシ樹脂および Ni / 樹脂接着部の吸水劣化挙動 三ツ木寛尚・鈴木 陸・荘司郁夫・小林竜也.....	359
	Investigation of Mechanical Properties of High Tg Epoxy Resin Material Xinya ZHAO, Hironao MITSUGI, Ikuo SHOHJI and Tatsuya KOBAYASHI.....	365
一般論文	ガス切断中のドロソ形成過程の三次元粒子法シミュレーション 古免久弥・須貝友裕・茂田正哉・田中 学 加藤 隆・北村祐一郎・佐藤豊幸.....	373
会報・掲示板	.....	N27

**Journal of Smart Processing**  
*Vol. 10 No. 6* 2021 (November 2021)

CONTENTS

異種・異材×接着・接合技術が拓く未来

<b>S.P.S. Announcement</b> .....	N23
Preface	Miki MORI .....327
<b>Reviews</b>	
Adhesion Technology for Dissimilar Materials Joining	Chiaki SATO .....328
Biomimetic Reversible Interconnect Design	Naoc Hosoda .....333
Metal / Plastic Dissimilar Material Joining Technology and International Standardization	Masami ITABASHI .....338
The Film-formed Adhesive Material for the Semiconductor Assembly Contributing to the Development of New Products	Isao ICHIKAWA .....344
<b>Research Papers</b>	
Controlling Size and Similarity of Anodic Porous to Reveal Joining Mechanism of Injection Molded Direct Joining Fuminobu KIMURA, Hao CHANG, Weiyang CHEN and Yusuke KAJIHARA .....	351
Deterioration Behavior of Epoxy Resin for Electronics Packaging and Its Adhesive Joint with Ni by Water Absorption Hironao MITSUGI, Riku SUZUKI, Ikuo SHOHJI and Tatsuya KOBAYASHI .....	359
Investigation of Mechanical Properties of High <i>T<sub>g</sub></i> Epoxy Resin Material Xinya ZHAO, Hironao MITSUGI, Ikuo SHOHJI and Tatsuya KOBAYASHI .....	365
<b>General Thesis</b>	
Dross Formation Process During Gas Cutting Using Three-Dimensional Particle Simulation Hisaya KOMEN, Tomohiro SUGAI, Masaya SHIGETA, Manabu TANAKA, Takashi KATO, Yuichiro KITAMURA and Toyoyuki SATO .....	373
<b>S.P.S. News</b> .....	N27